

NUMBER 178326

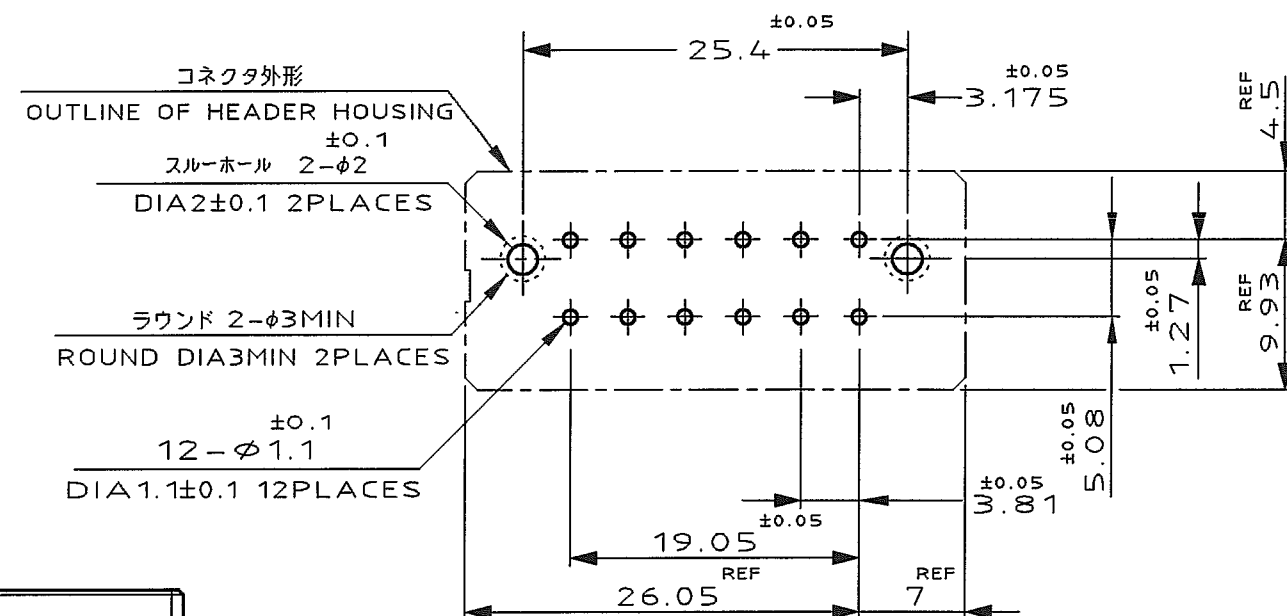
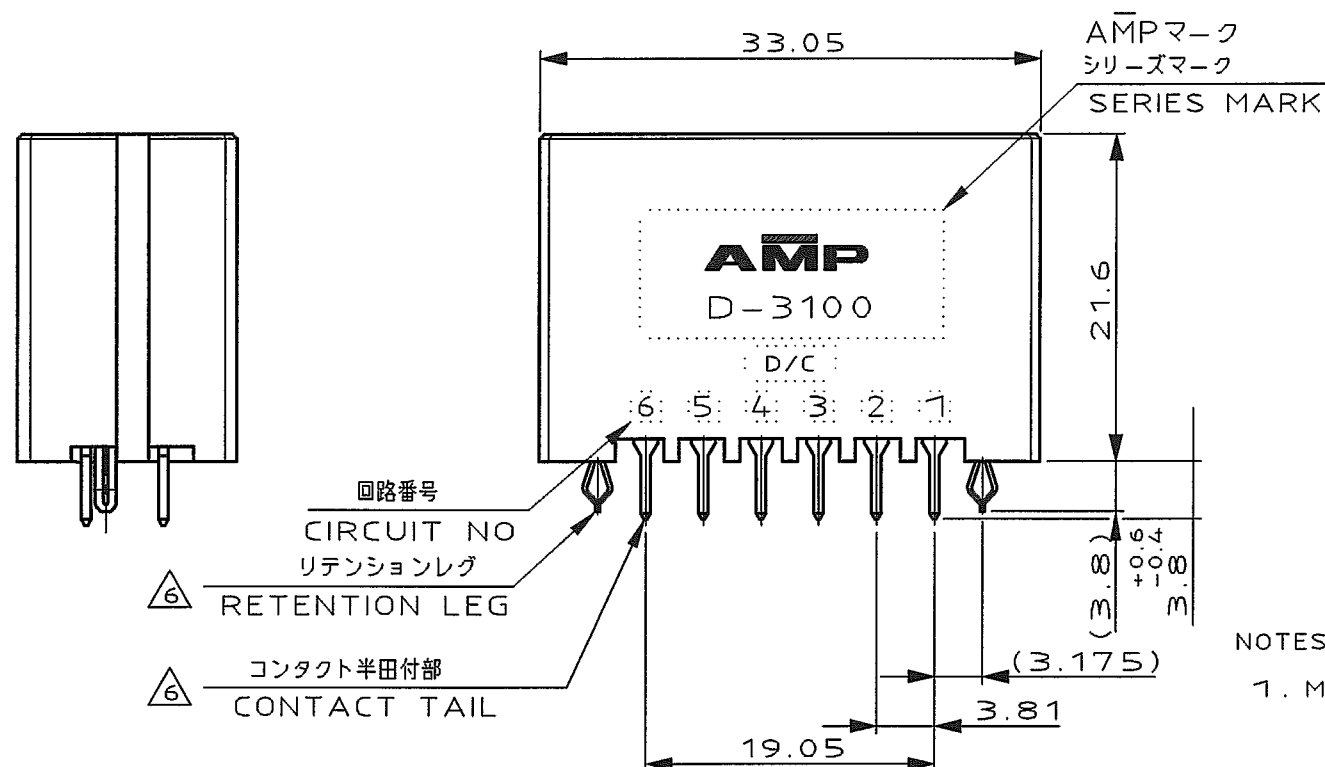
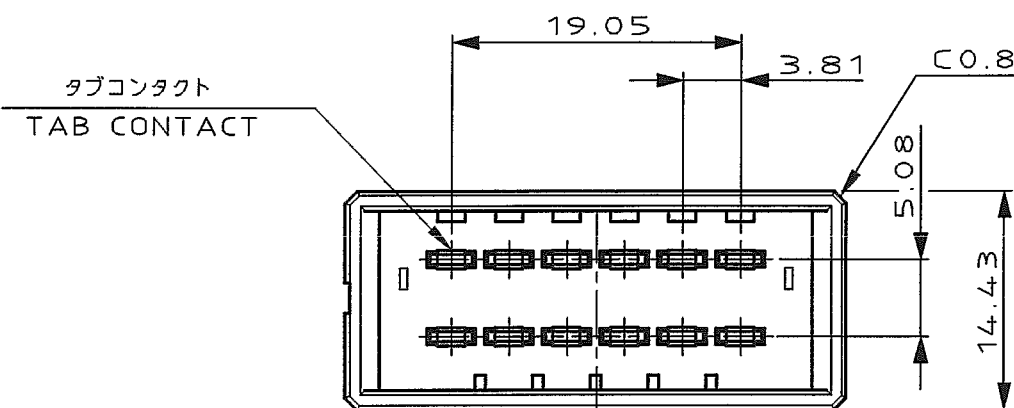


METRIC

PROJ NO.395-612

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83

推奨基板取付け寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂 (94V-0), 色: 黒
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

△6	△4	178326-5
△6	△3	178326-3
△6	△2	178326-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

B	REVISED	FJDO-0039-03	T S M	1/2	6/2
A	REVISED	FJDO-0114-03	T S M	1/2	6/30
O	RELEASED	FJDO-2528-95	NM	Y.I	6/30
LTR	REVISION RECORD		DR	CHK	DATE

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.			Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan		
WIRE RANGE mm ² (AWG -)		INSULATION DIA mm		NAME 12 POS DOUBLE ROW VERTICAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3100	
MATERIAL SEE NOTE 注記参照		FINISH SEE NOTE 注記参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC NUMBER
DR. 23 JUN 95 N. Matsubara		DE. 23 JUN 95 N. Matsubara		10mm以下 ±0.3 10mm以上 30mm以下 ±0.4 30mm以上 100mm以下 ±0.45 角 度 ±3°	A3 J C-178326
CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA		APP. 3 JUL 95 S. MANABE		SCALE 2-1	REV. B SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面